

愛普科技股份有限公司

2024.08.06 法人說明會

司儀

大家午安，我是愛普科技財務長林郁昕，歡迎您參與愛普科技法人說明會，在會議的初段，我們將進行本公司 2024 年第二季的財務狀況及業務報告，簡報過後會進入問答階段，線上參與的投資朋友可於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆。

Page.2 Disclaimer

免責聲明部分請各位留意。

Page.3~4

第 3 及第 4 頁是愛普科技的簡要資料，提供各位參考。

Page.5

本次法說會主要會分成 2024 年第二季財務數字重點說明、營運狀況以及未來展望，由團隊報告說明後進行 Q&A，今日的與會團隊除了我之外，有陳文良董事長、洪志勳總經理以及劉景宏資深副總經理。

Page.6

首先由我這邊進行財務狀況報告。

林郁昕 財務長

Page.7 (2Q IS)

首先說明 2024 年第二季的合併損益情形，愛普第二季在 IoT 應用領域出貨逐步回升之下，單季合併營收金額為新台幣 9.45 億元，較第一季增加 26%，但部分客戶對於總體需求仍保守看待，與去年同期相較減少 14%；毛利金額為 4.9 億元，QoQ 及 YoY 分別增加 41%及 10%；第二季毛利率為 51%，QoQ、YoY 分別增加 5 個百分點及 11 個百分點，毛利率的增加主要受到 IoT 及 AI 事

業部產品組合有利變化的影響，再加上高成本庫存晶圓逐漸消耗完畢，使整體毛利率提高。

本季營業費用為 2.6 億元，較上季增加約 1,800 萬元，QoQ 增加 8%，相較去年同期，則增加約 2,100 萬元，YoY 增加 9%。營業費用主要的增加來自於研發費用，研發費用季增 3 仟萬元，QoQ 增加 19%，年增 5,700 萬元，YoY 增加 44%，隨著研發人力的佈建及 AI 各項專案的開展，預期研發費用之金額將會持續上升。

營業利益為 2.3 億元，QoQ 金額增加 116%，主要是受營收及毛利率增加的影響；與去年同期相較，整體營收雖尚未回到去年同期水準，但在毛利率上升的挹注下，YoY 金額增加 11%。本季營業利益率為 24%，QoQ 因毛利率上升及營業費用率下降而增加 10 個百分點，YoY 則因毛利率上升而增加 5 個百分點。

業外收支部分，第二季業外收入為 2.1 億元，主要來自於利息收入 1.1 億元及兌換利益 1 億元。兌換利益來自於第二季底美金兌新台幣匯率升值 1.4% 的影響。因本公司 GDR 募資資金除了研發投入之外，尚未大幅動撥，加上既有的外幣資金、應收付款等淨外幣部位，持續會受到匯率波動的影響。再次跟投資先進說明，美金匯率的變化主要是造成本公司帳面金額的波動，對本公司並沒有實質影響。排除 GDR 相關兌換損益及所得稅影響數的擬制設算資料會在下一頁做說明。

第二季稅前淨利為 4.4 億元，所得稅費用為 7,200 萬元，包含第二季認列投資抵減所產生之所得稅利益金額約 1,600 萬元，所得稅有效稅率為 16.2%。稅後淨利金額為 3.7 億元，QoQ 維持相同水準，YoY 則減少 23%，淨利率為 39%，單季每股盈餘為 2.28 元。

Page.8 (2Q IS Pro forma)

如果排除 GDR 未支用資金所產生的兌換損益，2024 年第二季業外淨收入為 1.3 億元，主要來自於利息收入 1.1 億元及既有美金淨部位所產生之兌換利益 2,200 萬元。排除 GDR 相關匯率影響後，第二季淨利金額將為 3 億元，QoQ

增加 71%，YoY 減少 20%，淨利率為 32%，QoQ 增加 8 個百分點、YoY 減少 3 個百分點。擬制調整後每股盈餘為 1.88 元。

Page.9 (2Q BS)

合併資產負債表部分，季底總資產為 132 億元，較第一季底增加 4.4 億元。其中，現金及約當現金為 44 億元、按攤銷後成本衡量之金融資產為 51 億元，總計金額約 95 億元，合計占總資產的 72%。按攤銷後成本衡量之金融資產是本公司承作之三個月以上定期存款。與去年第二季季底，現金及按攤銷後成本衡量之金融資產這兩個科目合計數相較，淨增加數為 8.1 億元，主要來自於營業活動應收帳款的回收所帶來的淨現金流入。第二季底應收帳款 5.5 億元，較第一季底增加 1.8 億元，主要是需求帶動銷貨回升的連帶影響。第二季底存貨金額為 9.4 億元，較第一季底增加 2,900 萬元，上升 3%，目前庫存水位合理，將持續依據接單狀況來動態管理。另外，透過損益按公允價值衡量之金融資產為本公司對海寧長盟的投資部位。採用權益法之投資較去年同期增加 7.5 億元，主要來自本公司於 2023 年底取得來頡科技 4 百萬股，並於 2024 年 1 月底將其轉列為採用權益法之投資，使得該科目金額增加。

第二季底的總負債為 22 億元，負債比率為 17%，較第一季底增加 3,300 萬元，主要為合約負債增加 3.4 億元、應付帳款減少 5,300 萬元、應付所得稅減少 1.6 億元及償還 8,700 萬元短期借款的淨影響數。合約負債的增加，來自於 AI 事業部向客戶預收的 VHM™ 貨款的增加。

股東權益總金額為 110 億元，較第一季底 106 億元季增 4 億元，增幅 3.8%，YoY 則較去年同期 104 億元增加 6 億元，增幅 6.2%。每股淨值為 67.99 元。

以上是就財務資訊的相關說明，接下來的時間由洪志勳總經理說明營運狀況，謝謝!

洪志勳 總經理

Page.10

謝謝財務長；各位投資先進大家好，接下來由我為大家報告第二季的營運狀況。

Page.11 Qtrly Rev & GM%

2024 年第二季的營收為 9.45 億元，相較前季增加了 26%，主要是 IoT 市場需求從前季谷底回溫，YoY 則減少 13.8%，是由於 IoT 的 Connectivity 需求減少所影響。本季毛利率較前季提升了五個百分點，主要是 AI BU Licensing 營收增加導致 QoQ 毛利率升高。相較於去年同期，毛利率提高了 11 個百分點的主要原因是高成本晶圓庫存逐漸消耗完畢。我們預期下半年毛利率會在第二季這個範圍隨著產品組合的變化波動。

本季營收主要貢獻還是來自於 IoT BU，占營收的 91%。IoT 下半年延續第二季的拉貨動力，預計營收有所提升。AI BU 隨著新世代的礦機進入量產，下半年營收在 wafer sales 挹注以及 Licensing 營收預期穩定貢獻下，會較第二季顯著增加。

Page.12 Operating & Non-ope. Profit

下面我說明盈利的狀況。在這一頁上，左邊淺綠色是營業利益，隨著第二季的營收以及毛利率的提升，雖然營業費用有小幅增加，營業利益較前季大幅增加 116%。愛普科技的營收成長仍然是營業利益成長的主要驅動力，也是經營團隊專注努力的方向。

業外收支主要來自外匯兌換利益和利息收入，本季總共 2.1 億。因為本公司目前資金充足，業外收入是利潤的一個重要組成部分。

Page.13 Net Income

第二季總體淨利為 3.7 億元，與第一季淨利約當，淨利率因營收增加，從第 1 季的 49% 減少為 39%，還是維持在穩定的水準。

接下來我就兩個事業部在 2024 第二季營運狀況分別為各位先進說明。

Page.14 IoT BU

首先我們來看 IoT 事業部。

本季營收 8.56 億元，較前季增加 32%，對比去年同季則是減少 15%，這主要是 Connectivity 需求較弱的影響。

IoT 事業部的主要應用領域分為三塊: Connectivity、Wearable 及 Video/Audio/ Others。

Connectivity 的主要應用是蜂巢式網路 (4G/ 5G modem)，WiFi、bluetooth 以及部分的 industrial IoT。Connectivity 應用在本季 IoT BU 營收中占比約 41%。這部分營收較前季增加了 52%，主要是因為客戶的庫存在第一季後回到較正常水位，恢復拉貨動能。較去年同期，Connectivity 的營收有明顯下降，主要是需求變弱。由於這塊市場比較集中，競爭也比較激烈。我們正在推出更好的解決方案，進一步提高性價比，提高客戶使用 IoTRAM™ 的動力。

在穿戴裝置的部分，本季金額較上季增加 12%，占本季 IoT 營收 30%。我們在前季向各位先進報告過，穿戴裝置市場在各個 segment 都是持續增長的，隨著產品的功能愈來愈複雜，對記憶體的需求也較以往增加，尤其是在中高階產品對記憶體在低功耗、高效能的要求也愈來愈嚴格，我們新世代的解決方案已有數家客戶導入下一代的產品設計中，預計這部分會在明年下半年貢獻營收。我們對於愛普在這個市場的長期領先地位相當有信心。

在 Video/ Audio/ Others 應用的營收較前季增加約 31%，在本季營收占比 29%，其中以 Smart Home 和小型 Display 相關的應用貢獻較大。Smart Home 產品在 AI 及連網應用的帶動下，不僅需求增加，對記憶體容量需求也隨之提升，我們看好這個市場的成長潛力。另外在 Display 的市場，客戶也看到了 IoTRAM™ 的規格優勢，與客戶在新的解決方案的討論也持續進行中，我們有信心 Display 會成為 IoTRAM™ 另一個主要的應用領域。

此外，我們之前提到的 Silicon Capacitor，也就是 S-SiCap™，應用在 HPC 產品嵌入封裝 substrate 的設計中，目前已和多家 Substrate 供應商合作，也有數個客戶專案順利進行中，預計在明年底、後年初會陸續進入量產，目前也有許多其他 HPC 的客戶在設計討論階段。HPC 產品，比如 GPU，功耗越來

越大，速度越來越快，對電容的需求也越來越大。嵌入 Substrate 是一個比較新的做法，可以進一步增加電容，提高系統性能，進而提升 SOC 的穩定度並且增加產品的效能，我們對於 S-SiCap™ 在 HPC 封裝領域的長期發展前景十分看好。

隨著 connectivity 客戶庫存回到正常水準，Wearable 以及 Display 需求增加，我們預期 IoT BU 在下半年營收能持續成長。

Page.15 AI BU

接下來我們看 AI 事業部。

第二季營收台幣 8,900 萬，較前季減少 9%，主要是新世代礦機在本季 wafer 出貨較少的影響，我們預期這部分在下半年會有較顯著的增加；另外，IP Licensing 在本季也因為專案進度達成而有營收認列，較前季有顯著增加。

AI 事業部營收主要分為 IP licensing、VHM™ 以及 S-SiCap™ Interposer wafer sales。

目前 AI 事業部經營的重點，專注於將 VHM™ 導入 AI/HPC 等主流應用市場。愛普科技的 VHM™ 是把 memory 疊在 SOC 上，為客戶提供更高頻寬、更低功耗的記憶體解決方案，相較目前 solution 的效能功耗比有很大的優勢。VHM™ 多層堆疊，在市場上叫做 VHMStack™，在 LLM(Large Language Model)的 inference 應用上，是目前最具效能與成本優勢的記憶體解決方案，已經獲得客戶的認可並且進行規格討論中。

在挖礦市場的部分，如剛才提到的新世代礦機，第一季已經進入量產，在下半年 wafer sales 對 AI BU 營收將會有顯著的貢獻。另外，我們與客戶正進行第三代的礦機設計，在效能功耗比上更加的提升，預計明年中進入量產。

S-SiCap™ 已經成功地應用在 2.5D 先進封裝的 interposer 上。現有市場上 2.5D 封裝的產能不足以滿足持續增加的需求，尤其是帶電容的 interposer，我們的 solution 是市場上最成熟的產品之一，目前已有多個客戶採用並 Tapeout，且持續有客戶接觸中，預期在明年會有顯著的營收貢獻。

AI BU 在下半年隨著新世代礦機的量產、VHM™ 新專案 NRE 的貢獻以及 Silicon interposer 逐漸進入量產，今年將會重回成長的軌道。

以上是兩個事業部的在第二季的 Update。隨著 IoT BU 各個新產品導入量產，AI BU 營收回升，長期來看，我們對營收穩步成長，毛利穩定期望不變。

以上是我的報告，接下來請董事長針對未來展望部分向各位投資先進做報告。

陳文良 董事長

Page.16

各位投資先進下午好。我是董事長兼執行長陳文良。我來跟大家報告我們對未來展望的一些看法。這次法說會我想從公司產品在市場上的定位這個角度來分享我們對未來的展望。

Page.17

我們首先看一下 IoT RAM™。IoT RAM™ 是公司目前主要的營收來源，也是我們最成熟的一條產品線。IoT RAM™ 的定位相較於標準型 DRAM 有五大特徵。第一是容量比較低。這個是針對 IoT 記憶體容量需求的精確定位。這個特徵也讓我們避開了 DRAM 行業的激烈競爭。第二是功耗比標準 DRAM 低一個數量級，這個特徵讓我們在穿戴市場取得了絕對優勢。第三是管腳少了幾倍，這個特徵讓我們客戶也減少管腳，降低主晶片的成本和面積。第四是晶片面積比標準 DRAM 小一個數量級，這個特徵讓我們的客戶進一步地縮小主晶片面積。第五是合理穩定的售價，不受 DRAM 行情影響，有利於客戶做長期的產品規劃。

憑借以上的全方位優勢，我們在市場上取得了相當好的認可度。但是，我們真正在經營的是（1）服務精神，以客戶的目標為目標，為客戶找到最好的解決方案；（2）可依賴性，我們提供可靠的供應，可靠的質量；（3）長期的堅持，10 年 20 年之後我們還會提供 IoT RAM™ 的服務。

本著這樣的經驗指導思想，我們在市場上已經逐漸取代越來越多的低容量的標準 DRAM。我們認為 IoT RAM™ 是一個長期持續成長的產品線。我們的競爭門檻是客戶對我們的信任。

疫情之後的這兩年 IoT RAM™市場有些波動，但是我們對 IoT RAM™市場的長期信心絲毫沒有動搖。

Page.18

我們接下來看一下 HPC 應用。最重要的一塊標為 1 號的 VHM™。大語言模型 LLM 的推論 (Inference) 帶來的需求是 VHM™的 Killer-Application。VHM™提供了最適合的容量、頻寬和功耗。這一塊應用的導入正在積極地進行，包含多個項目。除了 POC 概念驗證之類的項目之外，今年有望開始產品 Design-In。產品 Design-In 完成之後大約兩三年可以量產。剛才總經理有提到，加密貨幣應用的量產還會繼續。下一頁我還會進一步說明 VHM™在 DRAM 行業的定位。

標為 2 號的是帶 S-SiCap™電容的 Interposer。這一塊主要是用於 HBM3 和 HBM3E 的 2.5D 封裝，也就是主流 2.5D GPU 應用，是目前市場上最成熟的產品之一。隨著 2.5D 封裝技術從晶圓代工廠擴散到 OSAT，我們相信愛普的 Interposer 在市場上應用會越來越多。目前我們已經有多個 Tapeout。量產的時程要看客戶驗證的週期。我們很有信心，量產只是時間問題。

標為第三和第四的是分離式 S-SiCap™。Embedded 在 Substrate 的電容對下一代大功耗的 HPC 應用是不可缺少的。這是未來一兩年會成熟的市場。我們預計市場容量相當大，在未來五年有望成為公司營收的重要組成部分。

標為第五的供電方案也是我們的方向之一，也是公司投資來頡科技的策略目的。但是目前還沒有可以分享的進展。

Page.19

我想用這一張圖進一步說明 VHM™技術在 DRAM 行業的歷史性地位。橫軸是 DRAM 標準的演變，縱軸分別是 DRAM IO 數目和 Bandwidth 頻寬。IO 數目和頻寬有直接的關聯性。2012 年左右 HBM 的出現讓 DRAM 的 IO 數目從 16 或者 32 提高到 1024。這個技術革命是圖像處理的需求帶出來的。但是 AI 到來之後 HBM 變成 AI 的主要 Memory 技術。但是後來的 HBM 的演進因為物理限制沒有再增加 IO 數目。一直到 VHM™的出現，把 IO 數目提高到 10 萬，

100 萬或更多。這個 100 倍以上的提高也大幅提高了頻寬。這樣的頻寬才能滿足 AI 的需求。VHM™ 這個新技術在市場上已經逐漸被接受。我們相信 VHM™ 會逐漸走向主流。我剛才提到的 LLM Inference 的應用只是一個開始。

Page.20

最後，我向各位做一個總結。

VHM™ 在 LLM Inference 應用的導入正在積極進行中。加密貨幣量產也在繼續中。VHM™ 是公司技術發展的重點。

IoTRAM™ 市場穩定。我們去年提出的一個新的低功耗介面已經被多家一線的客戶接受。這個介面有望進一步擴大 IoTRAM™ 的市場。

S-SiCap™ Interposer 公佈不到一年已經有多個 Tapeout。量產在未來兩三季可以期待。

分離式的 S-SiCap™ 在嵌入 Substrate 的應用已經跟多家 Substrate 公司合作，有望在未來 1-2 年開始量產。

另外我也想更新一下公司對 GDR 資金使用的規劃。我們使用 GDR 資金打造 3DIC 生態鏈的目的沒有變。隨著 VHM™ 市場需求量越來越明確，一部分投資項目會在未來兩到三季開始實施。其中一部分會是設備投資。整體投資規劃會持續幾年。

總體來說，愛普最近幾年佈局的產品方向逐漸落地。我們對愛普未來的成長充滿信心。

歡迎大家提問!

Page.21

司儀

謝謝董事長。

本次的簡報到這裡告一段落，接下來進入問答階段，請各位投資朋友於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆，謝謝。

現在，第一個提問的問題是.....。

回覆第一個問題:。

下一個提問的問題是.....。

回覆第二個問題:。

由於時間的關係，問答階段在此告一段落，會後若有其他問題，各位可聯繫本公司 IR 團隊。

感謝各位的參與，今天的會議到此結束。謝謝!